

Raporty Spółek ESPI/EBI

Przydział obligacji imiennych serii J oraz K MODULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna (PLLSTHM00015)

28-06-2019 17:20:28 | Bieżący | EBI | 31/2019

Zarząd Module Technologies SA („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r., dokonał przydziału obligacji imiennych serii J o łącznej wartości, zarówno nominalnej jak i emisyjnej, 3 023 000 zł (trzy miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych). O zamiarze emisji obligacji serii J Spółka powiadamiała w raporcie bieżącym EBI nr 27/2019 z 07 czerwca 2019 r.

Przydział nastąpił na rzecz 36 podmiotów (osób fizycznych) w trybie określonym w art. 33 pkt 2) ustawy z 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

Obligacje podlegać będą wykupowi po okresie 36 miesięcy od dnia emisji (rozumianego jako dzień przydziału obligacji), będą oprocentowane w wysokości 8,25 procent w stosunku rocznym, płatność odsetek będzie następowała w kwartalnych okresach odsetkowych.

Ponadto Spółka w dniu 28 czerwca 2019 r. dokonała przydziału obligacji imiennych serii K o łącznej wartości, zarówno nominalnej jak i emisyjnej, 10 000 000 zł (dziesięć milionów złotych). O zamiarze emisji obligacji serii K Spółka powiadamiała w raporcie bieżącym EBI nr 28/2019 z 26 czerwca 2019 r.

Przydział nastąpił na rzecz 5 podmiotów (4 osób fizycznych oraz jednej osoby prawnej) w trybie określonym w art. 33 pkt 2) ustawy z 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

Obligacje podlegać będą wykupowi po okresie 36 miesięcy od dnia emisji (rozumianego jako dzień przydziału obligacji), będą oprocentowane w wysokości 8,25 procent w stosunku rocznym, płatność odsetek będzie następowała w kwartalnych okresach odsetkowych.

Podstawa prawna raportu: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

- Mirosław Pasięka - Prezes Zarządu
- Leszek Surowiec - Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu



Mirosław Pasięka

Wiceprezes Zarządu



Leszek Surowiec